

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2021-013

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年1月14日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了非公开发行新增股份登记托管手续。具体内容详见公司于2021年1月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《晶方科技非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公司编号：临 2021-002）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

注册号：913200007746765307

名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司

法定代表人：王蔚

公司住所：苏州工业园区汀兰巷 29 号

注册资本：人民币 339,344,764 元

实收资本：人民币 339,344,764 元

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、制造、封装和测试集成电路产品，销售本公司所生产的产品并提供相关的服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021年2月9日